



## Laser marking



Laser marking and engraving system  
Laserbeschriftungs- und Gravursystem

# BSP

## Flexibility : Flexibilität

The knowledge of the process and of the application needs combined with the construction characteristics make BSP an innovative system for simplicity and productivity.

The range of **sources from 20 to 100W** allows you to perform engraving, marking, surface processing and micro-cutting processes aligned with the highest standards available.

## Compact system

BSP has a compact and solid structure thanks to the granite working plane that guarantees **excellent process stability** for pieces up to 20 kg in weight. The base structure includes 3 motorized axes with 50 µm precision of movement, stroke on the plane of 300 x 300 mm and an amplitude along the Z axis of 300 mm. It can be equipped with a series of accessories like the rotating or rotary-tilting spindle, dynamic measuring and vision systems.

## Advanced software

Entirely developed by SISMA, the integrated software is the ideal solution for managing files and the entire marking process, even in the case of complex jobs: allowing you to fully exploit all the potential of BSP PICO, it guarantees a **high degree of customization** to speed up and simplify the operator's work.

- Die Kenntnis des Prozesses und der Anwendungsanforderungen kombiniert mit den Konstruktionsmerkmalen machen BSP ein innovatives System für Einfachheit und Produktivität.
- Die Auswahl an **Quellen von 20 bis 100 W** ermöglicht es Ihnen, Gravur-, Markierungs-, Oberflächenbearbeitungs- und Mikroschneidprozesse durchzuführen, die den höchsten verfügbaren Standards entsprechen.

## Kompaktes System

BSP hat eine kompakte und solide Struktur dank der Granit-Arbeitsebene, die eine **hervorragende Prozessstabilität** für Teile bis zu garantiert 20 kg schwer. Die Basisstruktur umfasst 3 motorisierte Achsen mit 50 µm Bewegungsgenauigkeit, Hub in der Ebene 300 x 300 mm und eine Amplitude entlang der Z-Achse von 300 mm. Es kann ausgestattet werden mit einer Reihe von Zubehör wie der Dreh- oder Dreh-Kippspindel, dynamischen Mess- und Visionsystemen.

## Fortschrittliche Software

- Die komplett von SISMA entwickelte integrierte Software ist die ideale Lösung für die Verwaltung von Dateien und den gesamten Markierprozess auch bei komplexen Aufträgen: damit Sie alle Potenziale von BSP PICO voll ausschöpfen können, garantiert sie ein **hohes Maß an Individualisierung** bis hin zur Geschwindigkeit und vereinfachen die Arbeit des Bedieners.



### Technical Data - Technische Daten

	200F EP	300F	500F	1000F
Active material - Aktives Material	Yb	Yb	Yb	Yb
Average power - Durchschnittliche Kraft	20 W	30 W	50 W	100 W
Wave length - Wellenlänge	1064 nm	1064 nm	1064 nm	1064 nm
Working frequency - Arbeitsfrequenz	1 ÷ 1000 kHz	1 ÷ 500 kHz	1 ÷ 1000 kHz	1 ÷ 4000 kHz
Impulse duration - Impulsdauer	3 - 500 ns	26 - 250 ns	6 - 500 ns	4 - 2000 ns
Peak power - Spitzenleistung	> 10 kW	> 10 kW	> 10 kW	> 10 kW
Pulse energy - Impulsenergie	> 1 mJ	> 1 mJ	> 1 mJ	> 1,2 mJ
Beam quality [M <sup>2</sup> ] - Strahlqualität [M <sup>2</sup> ]	< 1,6	< 1,6	< 1,6	< 1,6
Cooling system - Kühlsystem	Air / Luft	Air / Luft	Air / Luft	Air / Luft
Axis stroke (XYZ) - Achshub (XYZ)	300 mm x 300 mm x 300 mm			
Max piece weight - Maximales Stückgewicht	20 kg			
Precision - Präzision	0,05 mm			
Repeatability - Wiederholbarkeit	0,02 mm			
Power supply - Stromversorgung	230 V ± 15% 50/60 Hz - single phase - CEE 16A socket / Steckdose			
Power absorption - Leistungsaufnahme	1 kW			
Dimensions (L x D x H) - Abmessungen (L x P x A)	823 mm x 1329 mm x h 1904 mm (h 2400 mm with open door - mit geöffneter Tür)			
Weight - Gewicht	590 kg			

The features, images, performances, weights and measures contained in the catalogue are completely indicative and approximate and may change without notice. Die Merkmale, Bilder und Eigenschaften im Prospekt, sind vollständig indikativ und Näherungswerte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

01-2022